

Документите съдържат заличени лични данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Заглавие **UniPOS proposal 2 - zop procedure 233**
От Валентин Ценов <[REDACTED]>
Получател <zop@tu-sofia.bg>
Дата 02-08-2019 14:51



• scan20190208_3.PDF (~1,1 МБ)

На вниманието на Проф.,Д-р, инж. Валентин Видеков.

Уважаеми Г-н Проф. Видеков,

Приложено изпращаме нашата индикативна оферта относно обособена позиция 2 :

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции", за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020",

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове"

Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове"

УниПОС ООД, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 47

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от Вас покана на адрес <https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/233> Ви представяме наша индикативна оферта:

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“

Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове“

Вашите Минимални технически показатели за Обособена позиция 2 “Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове“.

Управлението на параметрите да става чрез контролери и персонален компютър снабдени с необходимите за функциониране, индикация и архивиране софтуер и устройства за визуализация (монитори и дисплеи).

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на територията на получателя.

1. Работно пространство по X/Y не по-малко от 90x90mm
2. Държател на подложки с размер по-големи от 50x50mm
3. Програмируема скорост на преместване по осите, не по-малък диапазон от 0,2 до 8 mm/s
4. Нагревател на подложките до температура не по-малка от 160 °C
5. Ход на главата по Z не по-малък от 25 mm
6. Резолуция на преместване по Z не по-лоша от 0,4 µm
7. Бондираща глава за челно бондиране (топче – клин) и кит за бондиране, диаметър на използвани проводници не по-малък диапазон от 20 до 50 µm,

8. Бондираща глава за странично бондиране (клин – клин) със завъртане на 360 градуса и кит за бондиране, диаметър на използвани проводници не по-малък диапазон от 20 до 50 μm ,
9. Ултразвуков генератор с мощност не по-малка от 30 W
10. Тестваща глава за усилия не по-малки от 100 g
11. Резолюция на тестване не по-лоша от 0,01 cN
12. Програмируемо усилие и скорост
13. Температурна компенсация
14. Гаранция минимум 12 месеца
15. Обучение за работа на 2 служители на Възложителя.

Срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение е до 170 календарни дни, от датата на регистрацията на договора в деловодната система на Възложителя.

Обща индикативна стойност по горните точки е: 236 600 (двеста тридесет и шест хиляди и шестотин) лева, без ДДС.

Оценката е на база експертен преглед на:

<https://www.asm-back-end-systems.com/en/bes/home>

<https://www.kns.com/Contact>

<http://www.westbond.com/4700E.htm>

<https://advpackaging.co.uk/wire-bonding>

<https://www.fsbondtec.at/tester-2/>

<https://www.palomartechologies.com/products/8000-wire-bonder>

02 август 2019

Изготвил: Петър Анков, УниПОПС ООД



Заглавие **UniPOS proposal - zop procedure 233**
От Валентин Ценов <[REDACTED]>
Получател <zop@tu-sofia.bg>
Дата 02-08-2019 09:18



- Скан_20190802 (2).jpg (~1,1 МБ)
- Скан_20190802.jpg (~1,4 МБ)

На вниманието на Проф.,Д-р, инж. Валентин Видеков.

Уважаеми Г-н Проф. Видеков,

Приложено изпращаме нашата индикативна **оферта** относно:

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции", за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020",

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове"

Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове"

УниПОС ООД, гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" 47



Скан_20190802 (2).jpg
~1,1 МБ



Скан_20190802.jpg
~1,4 МБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваната от Вас покана на адрес <https://zup.tu-sofia.bg/ZupProcedures/preview/233> Ви представяме наша индикативна оферта

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно: Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по механика и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“

Обособена позиция № 2 „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове“

Вашите Минимални технически показатели за Обособена позиция 1 „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“:

Управлението на параметрите да става чрез контролери и персонален компютър снабдени с необходимите за функциониране, индикация и архивиране софтуер и устройства за визуализация (монитори и дисплей).

Инсталирана и въвеждана в експлоатация на територията на купувателя.

1. Работна маса по X- Y не по-малко от 100x200 mm.
2. Работна глава с преместване по Z - не по-малко от 90 mm с разрешаваща способност не по-лоша от 1µm. Работната глава да е с контрол и управление на усилията в диапазон не по-малък от 20 – 400 g с точност 1g и разширение за усилие не по-малко от 3 kg.
3. Взаимно завъртане на подложка (корпус) и елемент (чип) около ос Z на 360°.
4. Блок за подгряване на инструмента не по-малко от 400 °C, комплект с ултразвуков генератор с мощност не по-малка от 30 W.
5. Държател/и за подложки (корпуси) с размер не по-малки от 50x50 mm, с фиксиране чрез вакуум или механично.
6. Вземане на елементи от различни носачи (схрайбирани пластинки, тарги).
7. Устройство за подгряване на държател (масимка) до температура не по-малко от 400 °C, и държател с размер за поставяне не по-малък от 30 mm.
8. Модул за усилено нагряване на държател със скорост достигане не по-малко от 25 °C/s, с програмируем профил и режим на охлаждане.

Ср. 1/04

9. Комплект за разполагане тип обърнат монтаж (flip chip) със система за прецизно визуализиране и позициониране.
10. Система за визуално наблюдение с цветно изображение с висока резолюция и зрително поле не по-малко от 1,5x1,5 mm.
11. Устройство за работа в инертна среда,
12. Две притежае диспенсърна система
13. Да осигурява вакуумно захващане,
14. Комплект игли: три типа – вземане на чип за поставяне със залепване и диаметър между 150 и 300 µm; вземане на чип за спояване с размер между 200 и 1500 µm; вземане на чип за ултразвуково заваряване с размер между 200 и 1500 µm.
15. Гаранция минимум 12 месеца.
16. Обучения за работа на 2 служители на Възложителя.
Срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение в до 170 календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на Възложителя.

Обща индикативна стойност по горните точки е: 238 400 (двеста тридесет и осем хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.

Оценката е на база експертен опит при доставката на оборудване за разполагане на чипове използвано в нашата фирма.

01 август 2019

Изготвил: Петър Анков, УниПСПС ООД

Заглавие **на вниманието на проф. В. Видеков**
От Vladimir Stavrov <[REDACTED]>
Получател <zop@tu-sofia.bg>
Копие до Gala Stavreva <[REDACTED]>
Дата 31-07-2019 13:29



-
- Индикативна оферта Видеков.pdf (~1,5 МБ)

Здравейте проф. Видеков,

Изпращам Ви индикативната оферта за монтажно оборудване.

Поздрави,

Владимир Ставров
АМГ Технолоджи ООД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно: „Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции“, за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, съгласно технически спецификации:

Обособени позиции:

1. „Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“
2. „Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове“

Уважаеми господа,

Съгласно публикуваната от Вас покана, Ви представяме нашата индикативна оферта:

I. Вашите Минимални технически показатели за позиция 1 “Полуавтоматична станция за разполагане на микрочипове“

Управлението на параметрите да става чрез контролери и персонален компютър снабдени с необходимите за функциониране, индикация и архивиране софтуер и устройства за визуализация (монитори и дисплеи).

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на територията на получателя.

1. Работна маса по X- Y не по-малка от 100x200 mm;
2. Работна глава с преместване по Z - не по-малко от 90 mm с разрешаваща способност не по-лоша от 1µm. Работната глава да е с контрол и управление на усилието в диапазон не по-малък от 20 – 400 g с точност 1g и разширение за усилие не по-малко от 3 kg;
3. Взаимно завъртане на подложка (корпус) и елемент (чип) около ос Z на 360°;
4. Блок за подгряване на инструмента не по-малко от 400 °C, комплект с ултразвуков генератор с мощност не по-малка от 30 W;
5. Държател/и за подложки (корпуси) с размер не по-малки от 50x50 mm, с фиксиране чрез вакуум или механично;
6. Вземане на елементи от различни носачи (скрайбирани пластини, тари);
7. Устройство за подгряване на държател (масичка) до температура не по-малко от 400 °C и държател с размер за поставяне не по-малък от 50 mm,
8. Модул за ускорено нагряване на държател със скорост достигаща не по-малко от 25 °C/s, с програмируем профил и режим на охлаждане;

9. Комплект за разполагане тип обърнат монтаж (flip chip) със система за прецизно визуализиране и позициониране;
10. Система за визуално наблюдение с цветно изображение с висока разделителна способност и зрително поле не по-малко от 1.5 x 1.5 mm;
11. Устройство за работа в инертна среда;
12. Да притежава диспенсърна система;
13. Да осигурява вакуумно захващане;
14. Комплект игли: три типа – вземане на чип за поставяне със залепване и диаметър между 150 и 300 µm; вземане на чип за спояване с размер между 200 и 1500 µm; вземане на чип за ултразвуково заваряване с размер между 200 и 1500 µm;
15. Гаранция минимум 12 месеца;
16. Обучение за работа;
17. Срок на доставка не по-дълъг от 20 седмици.

Използвани източници:

<http://www.directindustry.com/prod/unitemp/product-61496-2036431.html>

<https://www.onboardsolutions.com.au/equipment/micro-electronics-2/die-bonders/tresky-t-3202-semi-automatic-die-bonder/>

<https://www.labx.com/product/die-bonder>

<https://set-na.com/products/>

<https://www.fsbondtec.at/maschinen/series-56/?lang=en>

<https://www.besi.com/products-technology/productgroup/die-bonding/>

<http://www.hybond.com/pages/diebond-about.php>

https://www.aemtec.com/fileadmin/exceet/downloads/aemtec/AEMtec_flyer.pdf

Обща индикативна стойност е, както следва:

239 000 (двеста тридесет и девет хиляди и триста) лева, без ДДС.

II. Вашите Минимални технически показатели за позиция 2

“Полуавтоматична станция за опроводяване на микрочипове“

Управлението на параметрите да става чрез контролери и персонален компютър снабдени с необходимите за функциониране, индикация и архивиране софтуер и устройства за визуализация (монитори и дисплей).

Инсталиране и въвеждане в експлоатация на територията на получателя.

1. Работно пространство по X/Y не по-малко от 90 x 90mm;
2. Държател на подложки с размер по-големи от 50 x 50mm;
3. Програмируема скорост на преместване по осите, не по-малък от диапазона от 0.2 до 8 mm/s;
4. Нагревател на подложките до температура не по-малка от 110 °C;

5. Ход на главата по Z не по-малък от 50 mm;
6. Разделителна способност на преместване по Z не по-лоша от 0.4 μm ;
7. Бондираща глава за челно бондиране (топче - клин) и кит за бондиране, диаметър на използвани проводници не по-малък от диапазона от 20 μm до 50 μm ,
8. Бондираща глава за странично бондиране (клин – клин) със завъртане на 360 градуса и кит за бондиране, диаметър на използвани проводници не по-малък от диапазона от 20 μm до 50 μm ,
9. Ултразвуков генератор с мощност не по-малка от 30W;
10. Тествача глава за усилия не по-малки от 100 g;
11. Резолуция на тестване не по-лоша от 0,01 cN;
12. Програмируемо усилие и скорост;
13. Температурна компенсация;
14. Гаранция минимум 12 месеца;
15. Обучение;
16. Срок на доставка 16 седмици след подписване на договор.

Използвани източници:

<https://www.tpt-wirebonder.com/en/applications/bump-bonding.html>

<https://www.asm-back-end-systems.com/en/bes/home>

<http://www.westbond.com/4700E.htm>

<https://www.kns.com/Contact>

<https://www.inseto.co.uk/microelectronic-equipment-mpp-iBond-5000-wedge-bonder.php>

<https://www.palomartechologies.com/products/8000-wire-bonder>

<https://advpackaging.co.uk/wire-bonding>

Обща индикативна стойност е както следва:


236 100 (двеста тридесет и шест хиляди и сто) лева, без ДДС.

Срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение общо за поз. 1 и 2 – до 180 дни, считано от датата на регистрирането на договора в деловодната система на Възложителя.

31.07.2019

Изготвил: .. 

Владимир Ставров.

Управител 

АМГ Технологии ООД

